TOKAI RIKA

PRESS RELEASE

2024 年 1 月 18 日
株式会社 東海理化

「エレクトロニクス開発・実装展」に出展

株式会社東海理化(本社：愛知県丹羽郡大口町　代表取締役社長：二之夕 裕美)は、1 月 24 日(水)から 1 月 26 日(金)まで東京ビッグサイトにて開催される「エレクトロニクス開発・実装展」(第 38 回 ネプコンジャパン）に出展します。

当社は「人が手掛けないことこそやる」の創業精神のもと、自動車部品業界で培われた技術で事業を拡大してきました。その技術をさらに進化させ、新たなビジネスパートナーとの出会いに期待し、顧客・地域・社会課題の解決を目指して挑戦する思いから、当展示会へ出展します。

今回当社ブースでは、下記のカテゴリーにて展示します。

◇主な展示品

・磁気、電流、分光、超音波等各種センサ製品

小型化・軽量化・少量生産に対応可能な各種センサや高精度プラスチックマグネットによるカスタム対応品

・カスタム IC（*ASIC）製品

少量生産に対応可能なカスタム IC による小型化、軽量化、高機能化

⇒ 磁気、電流、光学、超音波等各種センサ製品、カスタム IC の紹介パネル

*ASIC…電子部品の種別の 1 つで、特定の用途向けに複数機能の回路を 1 つにまとめた集積回路の総称。

◇出展場所

東京ビッグサイト　東展示棟 E30-22

会場地図

◇来場登録サイト

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=0955872411545448-KDA

＜本件に関するお問い合わせ先＞　株式会社東海理化　総務部広報室（0587-95-5211）